

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*10年分まとめてCD1枚に収録!

貴金属メッキ方法と工程

公報種別 収録年数 収録点数
 [登録・公開編] 平成12年～平成21年(10年間) 790点

全文PDF CD-ROM 版 合計¥231,700 ¥136,500 - (税込価格)

		収録既刊セット		(本体価格)
No,10429	登録・公開特許	貴金属メッキ方法と工程	平.21	72点 ¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点 ¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点 ¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点 ¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点 ¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点 ¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点 ¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点 ¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点 ¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点 ¥23,100

(収録点数・内容は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。)

今までお客様にご愛顧頂いております「特許収録セット」を、約10年分のデータを集結した「特許収録セット10年セット版」をご用意いたしました。過去10年間に発行いたしました各テーマの収録セットの内容を全てCD一枚に収録し、検索機能もできるCD-ROM版と同様に「しおり機能」「ハイパーリンク機能」の2大機能を付加してお届けします。

しかも!過去10年間の特許収録セットをまとめた上に、お値段は全収録セット合計金額の

30～50%OFF!! という超お買得商品としてご提供いたします!

またご希望のお客様には平成11～20年版の「Vol.8」もご用意しております。

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[10年セット版はPDFファイルに「しおりリンク機能」、目次に「ハイパーリンク機能」を付加しております。]

ご注文頂きましたら6～7営業日中に請求書同封の上お送り致します。

お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No. X006 (Vol.9) CD-ROM版
所 属 部 署	題 名 「 貴金属メッキ方法と工程 (10年セット版)」 合計(税込価格)¥ 136,500 -
担 当 者 名	E-mail () FAX ()
住所 〒	

料金には別途送料がかかります。

貴金属メッキ方法と工程 No.X006(Vol.9)

[登録・公開編] 平成12年～平成21年(10年間) 790点

CD-ROM版 ¥136,500 (税込価格)

日本特許公開	平成12年
選択的なパラジウムめっきを有するリードフレーム	テキサス インストルメンツ インコーポレイテッド
金属を還元析出させるための水溶液はんだ濡れ性に優れたリードフレーム用銀めっき材	株式会社大和化成研究所
リードフレーム及びその製造方法	ソニー株式会社
柔軟性のあるケーブル用線状導体の製造方法	株式会社三晃製作所

日本特許公開	平成13年
耐熱,耐食性銀めっき材	日鉱金属株式会社
化学気相堆積により堆積した銅の密着性を高める方法	アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
硫酸テトラアミンパラジウムの製造方法	ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド
電気コネクタと、電気メッキ浴と、耐摩耗性表面を形成する方法	ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド
金結晶薄膜の形成方法	キヤノン株式会社

日本特許公開	平成14年
無電解金めっき液及びその建浴方法	株式会社日立製作所
水溶性イリジウムめっき浴及びそのめっき方法	日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社
金合金メッキ液	セイコーインストルメンツ株式会社
微小めっき部位を有するめっき物のめっき装置	日本エレクトロプレイティング・...
装飾部材	松本 洋介
パラジウムメッキ液及び該メッキ液を用いたパラジウムメッキ方法	株式会社ビクトリア

日本特許公開	平成15年
被覆金属製品	ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド
置換金メッキ液	日本エレクトロプレイティング・...
金めっき液	日本高純度化学株式会社
装飾品およびその製造方法	シチズン時計株式会社
配線板およびその製造方法	松下電器産業株式会社

日本特許公開	平成15年
被覆金属製品	ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド
金めっき液	日本高純度化学株式会社
装飾品およびその製造方法	シチズン時計株式会社
配線板およびその製造方法	松下電器産業株式会社
コンタクト	日本航空電子工業株式会社

日本特許公開	平成17年
触媒組成物および析出方法	ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.
半田付け用端子の製造方法	松下電工株式会社
メッキ用添加剤およびそのメッキ製品	丸山 裕之
表面処理方法およびその装置	同和鉱業株式会社
端子、それを有する部品および製品	F C M株式会社

日本特許公開	平成18年
メッキ装置及びメッキ方法	三井金属鉱業株式会社
錫-銀合金めっき浴	株式会社大和化成研究所
めっき皮膜ステンレス鋼	松下電工株式会社
メソポーラス金属膜の製造方法	学校法人早稲田大学
部分メッキ装置および部分メッキ方法	株式会社フルヤ金属

日本特許公開	平成19年
複合被覆銅線及び複合被覆エナメル銅線	東京特殊電線株式会社
貴金属めっきを施したチタン又はチタン合金材料	日鉱金属株式会社
半導体装置用リードフレームとその製造方法	松下電器産業株式会社
電子部品用銀めっき金属部材及びその製造方法	DOWAホールディングス株式会社
貴金属めっきを施したチタン又はチタン合金材料	日鉱金属株式会社
可動接点用銀被覆複合材料およびその製造方法	古河電気工業株式会社

日本特許公開	平成20年
めっき方法	日進化成株式会社
被覆タービンエンジン部品及びその製造方法	ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
基板処理装置及び基板処理方法	株式会社荏原製作所
導電性微粒子、基板構成体及び微粒子のめっき方法	積水化学工業株式会社
金バンプ又は金配線形成用非シアン系電解金めっき浴	エヌ・イーケムキャット株式会社

日本特許公開	平成21年
電解金めっき液及びそれを用いて得られた金皮膜	日本高純度化学株式会社
金めっき構造体の製造方法	トヨタ自動車株式会社
可動接点用銀被覆複合材料およびその製造方法	古河電気工業株式会社
メッキ方法およびその方法により製造されたメッキ皮膜を備えたメッキ品およびメッキ液	三菱電機株式会社
めっき被覆部品及びその製造方法	ソニー株式会社

各年度より抜粋